

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【20250501】

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信证券、光证资管、西部证券、朱雀基金、兴业证券、东财基金、方正证券、国联民生、浙商证券、财通证券、南京证券、亘曦资产、申万宏源、友邦保险、同泰基金、浑璞投资、中泰证券、中金公司、盘京投资、中华保险、汇百川基金、鹤欧投资、国泰海通证券、国信证券、西南证券、华泰资管、国元自营、宁波英领、长信基金、金元顺安、深圳红华、华能贵诚、上海钦沐、光大证券、嘉实基金、东吴证券、华泰证券、上海德汇、华西证券、君和资本、招商证券、泓澄投资、长江证券、上海睿源、德睿恒丰、北京星允、广发基金、上海朴信、宏鼎财富、元兹投资、珠海德若、深圳亘泰、上海涌贝、上海人寿、雷钧资产、国寿安保、西部利得、远洋资本、榕树投资、中国民生银行、国融基金、湖南长心、中信建投、汇添富基金、泰石投资、邦政资产、玄卜投资、上海杭贵、上海于翼、北京致顺、深圳丞毅、世诚投资、上海呈瑞、上海晨燕、IGWT Investment、汇泉基金、中意资产、LSQ management、宏利资产、JK Capital Management Ltd.、天惠投资、MFS Investment Management、百川财富、红杉中国、重庆渝汇、银华基金、汇丰晋信、西藏源乘、深圳兴亿、景顺长城、西藏东财、华夏基金、上海冰河、财富证券、中信保诚、平安基金、上海从容、中航赛维、尚诚资产、杭银理财、东方基金、恒盈富达、中天汇富、百嘉基金、上

	海毅木、平安银行、尚正基金、博裕资本（以上排名不分先后）
会议时间	2025 年 5 月 16 日
会议地点	进门财经线上会议
上市公司接待 人员姓名	董事长：郑广文先生 总经理：张璇女士 董事会秘书：梁倩倩女士
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、总经理张璇女士介绍公司业绩及近况 各位投资人大家好，欢迎参加公司本次交流会，感谢大家对公司的关注与支持！ 公司基于半导体行业特性及发展趋势，秉持平台化、国际化与可持续发展理念，深化大客户战略，强化核心技术攻关与产能储备，致力于打造全球领先的半导体零部件平台型企业，以应对行业增长机遇与客户高端需求，公司截止目前的主要布局如下： 1、平台化发展 公司以零部件业务起家，产品覆盖光刻、刻蚀、沉积等前道核心制程设备，可提供精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装以及检测等一站式服务。2024 年公司实现营业收入 30.4 亿元，同比增长 47.14%；扣非归母净利润 1.72 亿元，同比增长 98.98%，业务规模与质量同步提升。其中，机械及机电零组件业务实现营业收入 20.84 亿元，近 5 年复合增长率 38.15%；公司于 2018 年起布局的气体传输业务作为第二增长曲线，2024 年实现营业收入 8.79 亿元，近 5 年复合增长率 71.71%，第二增长曲线高速发展同时通过产业链外延投资加速平台化能力整合。 2、国际化布局 公司于美国、日本设立子公司，强化海外客户响应能力，打通国际与国内技术融合渠道。在新加坡设立研发与制造基地，目前已完成客户验证，与海外客户合作进一步加深。2024 年公

司大陆以外地区实现营业收入 8.97 亿元，同比增长 48.98%。新加坡产能布局有效规避关税壁垒，成本优势显著，进一步巩固国际竞争力。

3、技术攻关突破

针对先进制程对零部件洁净度及耐腐蚀性的严苛要求，公司突破海外技术垄断，实现喷涂技术与纳米薄膜技术自主化，产品孔隙率与耐等离子体腐蚀性达国际先进水平。随着芯片制造及国产装备向更先进制程演进，公司表面处理技术优势会进一步凸显。2024 年公司研发团队规模达 548 人，占总人数比例 16.81%，本科以上占比 81.02%，为技术迭代提供坚实人才支撑。

4、产能与人才储备

截至 2024 年末，公司固定资产规模达 40.25 亿元，总人数增至 3,259 人，较 2022 年增长 77%。截至目前，公司南通、北京工厂已逐步投产，新加坡厂已完成客户认证陆续投入使用，随着规模增长及产能释放，公司边际效益将大幅提升。

公司将通过“内生增长与外延投资”协同发展，平台化能力已得到初步验证。短期虽需消化投入成本，但依托技术壁垒与全球化布局，公司将在国产替代 2.0 阶段占据先发优势。

接下来请各位投资人提问。

二、投资者 Q&A 环节

Q1：在中美贸易摩擦持续深化的背景下，公司海外客户需求节奏是否发生显著变化？未来将如何应对此类挑战？

A：公司始终坚持大客户战略，与全球行业头部客户建立深度协同关系。回溯 2018 年中美贸易摩擦初期，公司境外收入为 1.88 亿元（占总营收 86.01%）；至 2024 年，境外收入规模已稳步提升至 8.97 亿元，年均增长率达 62.83%，营收占比优化至 30.25%。这一结构性调整印证了公司在海外市场的持续渗透能力，以及与国际客户长期合作关系的强韧性。

	另外，国际头部客户选择战略供应商时，高度关注质量体系、交付能力、成本优势及供应链韧性等核心要素。公司前瞻性布局新加坡生产基地，深化与海外客户的协同合作，显著增强供应链稳定性与成本竞争力。目前新加坡产能已通过客户验证并逐步释放，其区位优势可有效规避关税壁垒，进一步巩固公司全球交付能力。 Q2: 2024 年及 2025 年一季度业绩承压的核心原因是什么？未来盈利能力如何改善？ A: 公司作为技术密集型与资本密集型产业代表，近年来为应对全球半导体供应链重塑及长期发展需求，持续加大境内外产能建设、高端人才储备、战略物资采购及研发投入。短期内因多项战略投入集中兑现，导致费用端阶段性承压。随着南通、北京及新加坡基地产能逐步释放，叠加规模效应显现，公司边际成本有望降低，盈利水平会进一步提升。 Q3: 北京亦盛项目当前进展如何？后续协同规划有哪些？ A: 为完善半导体零部件平台化战略布局，公司于 2024 年 7 月披露筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司（以下简称“北京亦盛”）公告。截至目前，受产能爬坡及客户认证周期等因素影响，北京亦盛暂未实现稳定盈利。为保护投资人利益，且根据交易审慎性原则，公司将在北京亦盛盈利 5,000 万后启动审计评估，后续收购仍需履行相关决策及监管审批程序。具体详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上交所网站上披露的《关于筹划收购北京亦盛精密半导体有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 Q4: 公司在金属零部件产品的竞争优势是什么？如何巩固大客户份额？ A: 主要分三个方面： （1）客户合作壁垒：公司已通过国际龙头设备商及国内主流厂商的严苛认证，深度绑定客户研发与量产环节。（2）工艺
--	---

	技术优势：公司掌握覆盖精密加工、表面处理等全链条工艺能力，产品性能达全球半导体设备龙头企业标准，同时通过多种的制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能有利于客户降低供应链成本、提升采购效率，使得双方合作关系更加紧密。 （3）产业链协同：公司通过投资上下游关键环节，实现垂直产业链各关键环节的研发与制造协同，增强全球竞争力，提升定制化响应方案，加速平台化生态构建。 Q5：公司未来新品类拓展方向有哪些？ A：公司聚焦零部件领域打造平台型企业。其中，机械及机电零组件方面，公司将重点突破腔体内部件等高附加值产品，提升先进制程配套能力及产品市占率；气体传输系统方面，公司将深化与 Compart 公司业务、技术协同，整合气柜设计与制造能力，加速全球市场份额扩张。 Q6：当前公司产能布局与消化规划如何？ A：截至目前，公司在沈阳、南通、北京及新加坡均积极推进相关产能布局，用贴近式服务践行对客户的承诺。其中，南通富创作为公司 IPO 募投项目，已于 2024 年结项并成功投产，逐步释放产能。北京富创已完成客户认证，陆续投产。新加坡富创完成海外龙头客户验证，直接对接国际市场需求，助力公司国际化布局。 Q7：先进制程业务进展及未来技术规划？ A：富创坚持“傍大款、吃软饭、走绿色道路”发展理念，“傍大款”指聚焦大客户战略，服务国内外头部企业；“吃软饭”指在质量、工艺、生产组织方面建设软实力；“走绿色道路”指生产经营坚持节能环保理念。 2024 年，公司深度参与客户新机台研发与制造，在关键产品及关键技术上有较大突破。面向更先进制程，对零部件性能指标也提出更高要求，需要特殊的表面处理工艺。公司开发的“N 系列膜层、O 系列膜层”已成功突破腔内核心零件洁净度控
--	--

	制难题，通过头部客户认证并实现规模化生产。公司研发的“致密 Y0 涂层”技术已实现产品孔隙率达到国际先进水平，适配先进制程刻蚀机台内部零件防护需求，并稳定量产；“含氟涂层”已完成客户认证，进入小批量生产阶段。伴随逻辑与存储芯片制程迭代，公司表面处理技术优势将进一步转化为市场份额。 Q8: 请介绍下公司 2025 年一季度新签订单情况以及全年订单趋势预判？ A: 公司 2025 年一季度新签订单实现同比、环比双增长，当前在手订单覆盖产能爬坡需求。基于客户新机型量产周期及公司全球化产能释放节奏，公司对全年订单增长保持乐观预期。 Q9: 近期股东减持计划及公司应对措施？ A: 公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）在所持公司股票限售期满后，仍陪伴公司成长，但因自身资金需求拟于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日期间，将通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份。具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上交所网站上披露的《股东减持股份计划公告》。 同时，基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司拟实施增持股份计划，维护资本市场稳定和投资者利益，增持总金额不低于人民币 1.2 亿元，不超过人民币 2.4 亿元。具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上交所网站上披露的《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》。 Q10: 公司期间费用率处于较高水平，未来管理费用管控有何规划？ A: 公司 2024 年销售、管理、研发及财务费用合计占营业收入比例为 21.01%。阶段性费用上升主要系国际化产能建设及高端人才储备（尤其引进具备国际背景的核心技术与管理团队）。随着南通、北京、新加坡等基地产能释放及业务规模的扩张，
--	---

	规模效应将摊薄单位成本，费用率有望进入下行通道。 Q11: 当前产能储备是否面临结构性挑战？如何应对行业需求波动？ A: 从行业趋势上看，根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体制造设备出货金额达到 1,171 亿美元，同比增长 10%。受益于先进逻辑、成熟逻辑、先进封装和高带宽存储器产能扩张方面的投资持续增加，中国大陆巩固了其作为最大半导体设备市场的地位，投资同比增长 35%，达到 496 亿美元。中国大陆半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展，在先进制程领域的设备国产替代空间广阔。 公司作为半导体设备精密零部件的领军企业，深度绑定国内外头部设备商，在成熟制程国产替代基本盘稳固的同时，将持续加速拓展先进制程的增量市场，并通过沈阳、南通、北京、新加坡四地产能弹性调配，实现“本土需求快速响应+国际订单灵活承接”的双重保障。未来在行业增长与国产替代双轮驱动下，市场空间将进一步扩大。 Q12: 当前产能储备是否面临结构性挑战？如何应对行业需求波动？ A: 从行业发展趋势看，由于半导体零部件领域存在较高的技术壁垒，“强者恒强”的竞争格局将持续深化。头部企业将通过全球化布局、产能扩张和技术创新来强化竞争优势，同时依托产业链协同效应构建更深的护城河。 公司以“平台化能力+全球化布局”构建竞争壁垒，坚持自主研发和外延投资的双轮驱动。在市场端，公司同步服务国际龙头与国内主流设备商，平衡地缘风险；在产品端，公司覆盖机械及机电零组件和气体传输两大品类；在研发端，公司紧跟国际先进制程，研发先进技术，突破表面处理核心技术，适配先进制程需求；在制造端，公司垂直整合精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装以及检测等全链条能力，客户可一
--	--

	站式采购，降低管理成本；在产能端，公司在境内外设置生产基地，储备产能；在投资端，公司联合投资人共同收购国际品牌 Compart 公司，加速富创气体传输系统产品的市场竞争力。 公司会持续加速构建全球化业务平台，通过上下游产业链协同等方式加强实力壁垒，将行业头部效应发挥的更加明显。 Q13: 公司信息化系统建设进展如何？智能制造如何赋能人均效能提升？ A: 智能制造能力是富创的核心竞争力，公司自 2018 年起布局智能制造，目前已完成 8 大核心系统与 10 个数字化平台部署。2024 年度公司通过构建半导体精密零部件共性技术平台，系统性提升开发周期、制造能力与产品质量水平。在智能工艺领域，公司持续进行技术升级，气柜、机加智能工艺均迭代至 2.0 版本，降低质量问题的发生率。面向未来，公司将深化智能制造战略、深化 AI 驱动的智能化工系统，为全球半导体设备商提供兼具更高可靠性及快速响应能力的制造解决方案。 三、董事长郑广文先生结语 公司 2018 年营收仅 2 亿元时，即锚定“10 亿规模”目标；当前公司营收突破 30 亿元，将朝着“百亿级平台化、国际化企业”目标迈进。公司基于“客户-技术-产能-人才”等多维度优势，有信心在半导体国产替代 2.0 阶段实现跨越式增长，成为具备全球竞争力的精密制造解决方案提供商，富创精密待与投资者共同见证这一战略升级进程。衷心感谢各位投资者的长期关注、信任与支持，谢谢大家！
附件清单（如有）	风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息	不涉及

的说明	
日期	2025 年 5 月 16 日